

6387 **サムコ**

辻 理 (ツジ オサム)

サムコ株式会社社長

中国・台湾での体制を強化し、海外売上高の拡大を図る

◆アジア市場を積極的に開拓

当社は仙台に営業所を置いているが、3月11日に発生した東日本大震災による人的被害はなかった。間接的な影響としては、一部のモーター類、セラミック部材の納期が滞ったが、2~3カ月を経て回復している。復興支援としては、被災地にボランティアを派遣しており、その他、寄付なども行った。今後も長期的に支援を継続していきたい。

2011年7月期の売上高は52億53百万円(前期比22.8%増)、営業利益は8億10百万円(同74.9%増)、経常利益は7億42百万円(同80%増)、当期純利益は4億30百万円(同73.7%増)となったが、計画に対しては売上高・営業利益ともに未達となっている。装置別売上高は、CVD装置が12億83百万円(同12.2%増)、ドライエッチング装置が29億63百万円(同26.5%増)、洗浄装置が3億89百万円(同25.7%増)、その他(サービス・部品材料)が6億16百万円(同28.3%増)となった。売上高構成比は、CVD装置が24.4%、ドライエッチング装置が56.4%、洗浄装置が7.4%、その他が11.8%である。

当社製品の用途は、創業以来続けている研究開発用と、数年前に参入した生産用に分類される。研究開発用の売上高推移を見ると、伸び率は小さいが、依然として拡大基調にあり、毎年15億円前後を確保している。一方、生産用については、景気変動の影響を大きく受けるため、2009年7月期には、リーマンショックの影響で前期比3割以上の落ち込みとなった。翌年は横ばいで推移したが、アジア市場の開拓を積極的に進めた結果、2011年7月期から大幅に回復している。今後は、この生産機市場へのアプローチが成長の大きなポイントになると考えている。

分野別売上高については、オプトエレクトロニクス分野(LED、半導体レーザー)が31億32百万円となっており、全体の59.6%を占めている。電子部品・MEMS分野は7億76百万円となり、構成比は14.8%となった。この分野では、今期以降、パワーデバイスが大きなマーケットになるとみている。

地域別売上高構成比については、日本が58.6%となっており、前期の55.8%から若干拡大した。一方、アジアについては、絶対額は増えたものの、構成比は42.1%から36.4%に低下している。米国、欧州、その他を含む海外売上高は、前期比15%増と伸びているが、アジアはやや軟調だと言える。

受注高については、前期比で若干減少したが、リーマンショック後の大幅な落ち込みからは回復している。今後は海外市場を拡大し、新製品を投入することで、さらなる拡大を図っていきたい。受注残は17億49百万円となって、高水準を維持している。

◆拠点を拡充し、拡大する中国市場に対応

2012年7月期の方針としては、海外市場の開拓、重点マーケットの絞り込みに力を入れる。また、年間1~2機種の新製品を市場に投入することで、価格および利益の低下を防いでいく。加えて、製品群をインテグレートし、ひとつのソリューションを提供する企業を目指す「One Stop Solution 戦略」を推進していく。

具体的な取り組みとして、海外展開については、台湾では2010年8月に台南に新たなサービス拠点を開設した。また、9月7～9日に開催された SEMICON Taiwan2011 に出展している。現在、台湾では、半導体、液晶、オプトデバイスともに低調となっているが、年末～年始にかけて投資の動きがあることから、回復が見込まれる。

中国では、今期から来期にかけて、上海、北京以外にも拠点を拡充し、さらなる現地化を進めて拡大する市場に対応していく。現在、SEMICON China への出展、有力大学との共同研究、北京大学での薄膜技術セミナー開催など、さまざまなアプローチを継続しており、これらを通じて人的ネットワークを構築していきたいと考えている。LED 生産機については、ドライエッチング装置「330iPC」の中国バージョンを発表した。価格競争に強い製品となっているため、CVD 装置と組み合わせて拡販を図ってきたい。

2011年1月からスタートしたシンガポールの営業拠点では、インドの市場開拓を進めており、2～3年後には大きな市場を作り上げることができると考えている。

北米については、2010年8月、ノースカロライナに販売・サービス拠点を設置し、シリコンバレーの研究所と連携して活動を開始した。東海岸の有カメーカー（パワーデバイス、オプトデバイス）との業務もスタートしたため、成果に期待している。また、この拠点から欧州市場へのアクセスも開始しており、ドイツ、フランス、イタリア、チェコなどの顧客を開拓する予定である。アジアと比較して市場規模は小さいが、業績に大きく寄与する可能性があるため、積極的に進めていきたい。

以上の取り組みにより、2012年7月期は海外売上高33億80百万円、海外売上高比率53.7%を目指していく。

◆薄膜技術で世界の産業科学に貢献

重点マーケットとして、電子部品分野では、SiC系およびGaN系パワーデバイス、MEMS分野に取り組む。オプト分野ではLED、半導体レーザー、有機EL、高周波デバイス、シリコン分野ではTSV（三次元LSI）に力を入れ、ワンストップソリューションを提供していきたいと考えている。

当社では、ここ数年で製品のラインナップ化を図っている。一例として、ポッシュ機については、研究開発機「400iPB」、セミ量産機「800iPB」に続いて、本格量産機「800iPBC」を開発し、顧客ニーズに合わせたあらゆる用途に対応可能となった。また、液体原料を使ったLS-CVD装置についても、研究開発用から量産用トレーカセットまでラインナップ化している。

パワーデバイスは、家庭用のエアコンや冷蔵庫、新幹線のモーター、自動車、産業機械などに使われる省エネルギーの切り札であり、一部で着実に導入が進んでいる。材料は、これまではシリコン（Si）が中心であったが、耐電圧、耐熱性、電流特性などに大きな期待ができないことから、シリコンカーバイド（SiC）が使われるようになってきた。また、さらに耐電圧の高い窒化ガリウム（GaN）も期待できる材料である。SiCは加工が難しいが、当社としては、SiCにピアホールを形成する技術や成膜技術で市場を拡大していきたいと考えている。

LED市場については、液晶バックライトの需要が一巡したものの、照明用途は拡大を続けている。また、日本でもLEDに対する税制のインセンティブにより、流れが変わり始めた。国内の大手メーカーが設備投資を積極的に進めており、当社もその恩恵を受けている。

LED生産用装置のラインナップとして、CVD装置については、2インチウエハーでバッチ26枚の「3800L」、48枚の「4800N」、61枚の「5400」を揃えており、ドライエッチング装置についても、バッチ12枚の「230iPC」、27枚の「330iPC」に加え、アジア向けの低コスト機を市場投入した。設計の見直しを行い、部材の一部を現地から導入することで、「330iPC」と比較して30%以上のコストダウンを実現している。

当社は、薄膜技術で世界の産業科学に貢献することを経営理念としている。中期経営計画（2012年7月期～2014年7月期）の数値計画として、2012年7月期の売上高については、経済環境も考慮して63億円としたが、来期は75億60百万円、最終年度には100億55百万円を達成し、その後も20%の売上成長を継続していきたいと考えている。経常利益については、今期の目標を11億95百万円としており、来期は16億60百万円、最終年

度には 24 億 85 百万円を目指す。

◆質 疑 応 答◆

今期の売上高予想については、前期からの期ズレ分が加味されているのか。また、計画生産、リードタイムなどについても教えてほしい。

中国向け製品で約 3 億円の期ズレが発生したが、10 月には納品できる見込みであり、今期の売上予想に含まれている。生産については、これまで受注生産が中心であったが、前期から一部で計画生産をスタートさせた。即納ではないが、売れ筋製品については、1 カ月程度で納品できる体制を整え、競争力の強化を図っている。

当期の海外売上高について、国別の内訳を教えてください。

海外売上高は、過去最高となる 21 億 73 百万円となり、このうちアジアが 19 億 14 百万円であった。アジアの内訳は、台湾が約 12 億円(前期比 2 億円減)、中国が 6 億 92 百万円(同 3 億円増)、その他が 27 百万円となっており、台湾企業が中国に移っていることから、来期以降は、台湾と中国の売上水準が同程度になると予想している。

MO-CVD の状況を教えてください。

当社の製品はマルチチャンバーだが、市場を独占している 2 社は、大きなチャンバーで性能を確保している。当初は、チャンバーの大型化とともに均一性や膜質の低下が起きると予想していたが、想定したほど低下していないため、これに対抗すべく、当社では、製品の改良・コストダウンを進めている。

(平成 23 年 9 月 13 日・東京)